证券简称: 劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 20210429

	□特定对象调研	□分析师会议
投资者关系活动类	□媒体采访	√业绩说明会
别	□新闻发布会	□路演活动
711	□现场参观	
	□其他(请文字说明其他活动内容)	
参与单位名称及人	通过"劲拓股份投资者关系"微信小程序参与 2020 年度业	
员姓名	绩说明会的投资者	
时间	2021年4月29日	
地点	"劲拓股份投资者关系"微信小程序	
	董事长 吴限	
	董事兼总经理 徐德勇	
	董事兼副总经理 何元伟	
上市公司接待人员	财务负责人 邵书利	
姓名	副总经理兼董事会秘书 张娜	
	独立董事 何晴	
	独立董事 吴易明	
	独立董事 彭俊彪	
	一、吴董对于公司未来发展的前景看法	
投资者关系活动主	董事长 吴限: 您好,公司是电子制造领域的电子装备制造	
要内容介绍	专业企业,装备制造业的特点是长期稳定的发展,稳定发展	
	是公司的第一要务,未来公司继续稳扎稳打,不会冒进,有	
	序推动公司业务持续性发展。谢谢!	

二、光电平板(TP/LCD/OLED)显示模组目前订单情况如何,投产情况如何?

董事兼总经理 徐德勇: 您好! 公司光电平板 (TP/LCD/OLED)显示模组生产专用设备有持续性销售,后 续随着各大面板厂商扩产计划的实施,该类设备有市场需求。订单情况如达到披露标准,公司将及时履行信息披露义务。谢谢!

三、目前电子整机装联设备研发进展如何,面对下游行业增速放缓的情况,公司如何提高市占率?

董事、副总经理 何元伟:您好,公司研制的 SE 二代波峰焊和 MIS 系列选择焊等设备,有利于提升产品竞争力和扩大产品应用领域,已实现批量生产和销售。公司将持续加大研发力度,提高产品附加值,增强客户黏性;同时公司提供覆盖PCB 生产过程中的插件、焊接、检测等多个流程,为客户提供整套零缺陷焊接检测制造系统。谢谢!

四、5G 时代即将来临,智能手机,汽车电子将迎来大爆发, 2021 年公司电子整机装联设备是否能迎来大的机遇?

董事、副总经理 何元伟: 您好, 5G 基站、智能手机、汽车电子等行业的发展,将一定程度上带动电子整机装联设备需求的提升。谢谢!

五、SE 二代波峰焊, 3D-Lami 柔性穿戴贴合目前投产情况如何, 预计将对业绩带来多大推动?

董事兼总经理 徐德勇: 您好,公司 SE二代波峰焊和 3D-Lami 柔性穿戴贴合设备目前已实现销售,将扩大公司产品应用领域,提升产品竞争力。谢谢!

六、今年公司研发投入同比下降-17.32%, 今年是否考虑加 大研发投入?

财务负责人 邵书利: 2020 年度我司研发投入相较 2019 年度 有所降低,主要因为 2019 年度 3D-lami 项目初始研发投入较大,设备研发基本完成后,后续是性能提高的阶段,此部分的研发费用支出强度低于前期。2020 年度我司多个研发项目齐头并进,相较往年平均研发投入而言,我司 2020 年度的研发投入仍处于较高水平,为保持产品的竞争力,后期将加大研发投入力度,谢谢关注!

七、3D-lami 项目目前研发进展如何?是否达到预期?

副总经理、董事会秘书 张娜: 您好,公司为国内首家实现 3D-lami 柔性贴合设备进口替代的厂家,已有多条线的 3D 贴合设备投产使用,研发部门根据设备运转情况不断改进产品性能,提升产品精度,目前公司 3D 贴合设备良率达到国内领先水平,谢谢!

八、国内的电子焊接类设备企业数量众多,产业集中度较低,未来预计如何提升市场占有率?

董事兼总经理 徐德勇: 您好,公司为电子焊接类设备领域的领先企业,未来将持续加大研发力度,提高产品附加值,增强客户黏性;同时公司提供覆盖 PCB 生产过程中的插件、焊接、检测等多个流程,为客户提供整套零缺陷焊接检测制造系统,进一步提升市场占有率。谢谢!

九、公司所处行业的发展趋势如何?公司如何始终站在行业前沿?

董事长 吴限:您好,未来受益于 5G 基站、智能手机、汽车电子等需求推动,将带动对电子整机装联设备需求相应提升;随着国内 AMOLED 面板产线逐步建成投产,光电平板

(TP/LCD/OLED)显示模组生产专用设备需求有较大的增长空间。公司将密切关注客户需求,储备具有前瞻性的技术,提高公司技术实力和产品竞争力。谢谢!

十、公司产品替换一般周期是多长时间呢?

董事、副总经理 何元伟: 您好,公司电子焊接设备的使用寿命一般有七年,但是不同设备有不同的更换周期,主要取决于客户工艺制程的需求以及相关技术的更新换代情况,光电设备的更换周期相对电子焊接设备会快一些。谢谢!

十一、今年是否有收购股权、新设全资子公司或与其他企业或个人合资新设控股、参股公司的计划?

副总经理、董事会秘书 张娜:您好!公司所有重大事项,敬请关注公司在证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。谢谢!

十二、公司热工产品在半导体行业运用如何?

董事长 吴限:您好!公司经过 20 多年发展,在电子热工领域沉淀积累了很多的技术、人才和经验,拥有很多技术专利,该类技术与半导体热工设备具有共通性,有利于公司把电子热工方面的技术延伸应用至半导体热工领域。谢谢!

十三、目前公司总产能情况以及利用率情况是怎样的啊

财务负责人 邵书利: 您好!公司推动精益生产以来,生产效率得到有效提升,各主要产品线均按照客户的订单需求有序安排出货,随着客户订单的增加,公司生产任务较为紧张,急需快速提升产能。公司通过改进生产和出货流程,提高生产效率,缩短产品供应周期,以满足客户交付需求。感谢您的关注!

十四、钢铁价格上涨,会对公司主营产品带来怎样的影响,有无制定相应的价格策略?

董事兼总经理 徐德勇:您好!钢铁价格上涨对公司营业成本产生一定影响,为降低影响公司提前储备了部分原材料,并与主要供应商建立了战略合作关系,签订有长期合作协议,能够保持原材料价格相对稳定;同时公司不断提高产品附加值,增加高端产品销售占比,提高营业收入,保持公司产品毛利率稳定,谢谢!

十五、3D 贴合设备今年增速较快,是什么原因导致的,今年能否保持高增速增长?

副总经理、董事会秘书 张娜: 您好,公司 2019 年签订了多批 3D 贴合设备大额订单,由于该类设备价值量较高,验收周期较长,部分订单在 2020 年度实现验收并确认收入;后续随着各大面板厂商扩产计划的实施,该类设备仍有市场需求。谢谢!

十六、公司内部怎么定义未来发展的一些主要的板块?怎么 去看待未来发展的方向,每一个方向的着力点是什么样的, 大概是怎么样的分配?

董事长 吴限: 您好,公司致力于研发更高精密度、更高价值量的电子整机装联设备,提升该类设备的高端市场份额,并将该类设备相关电子热工方面的技术积累,拓展应用至半导体热工领域。同时,巩固光电平板(TP/LCD/OLED)显示模组生产专用设备取得的技术成果,推动光电业务持续性发展。谢谢!

十七、能否总结一下公司过去 2~3年的变化?

董事长 吴限: 您好,2018 年以来,公司电子整机装联设备 业务持续保持领先地位,光电业务亦取得了实质性进展,销

售占比逐年提升。2019 年度、2020 年度公司注重加大研发投入,研发投入相较 2018 年度分别增长了 99.17%、64.68%,有效提升了公司产品价值。谢谢!

十八、今年一季度的费用有比较多的增加,望吴董平衡各方面。能较好回报二级市场的投资者。谢谢

董事长 吴限: 您好! 2020 年度现金分红预案已经董事会审议通过, 待 2020 年度股东大会审议通过后实施。2021 年第一季度公司加大了研发投入, 扎实推进各项业务, 努力提升业绩, 以回报广大投资者, 谢谢!

十九、公司今年有无扩展海外市场的计划,具体是哪些业务?

董事兼总经理 徐德勇:您好,目前由于海外疫情影响,公司在东南亚地区的一些大客户对公司的设备本地化就近服务与技术支持要求高,公司正拓展布局海外服务中心。谢谢!

二十、实现营业收入同比增长 78.41%, 但是净利润却增长 了 443.74%, 公司能否解释下利润大幅增长的原因?

财务负责人 邵书利: 您好!公司本期业绩大幅增长的主要原因为:(1)本期部分国内厂家对国产生产设备需求增加,国内销售收入同比大幅提高;(2)本期部分海外客户扩产需求增加,海外销售收入同比大幅增长;(3)本期收到的软件退税及政府补助增加。谢谢!

二十一、公司的核心竞争力或者护城河是什么?

董事长 吴限: 您好,公司的竞争优势: 1、公司已有二十余年的技术、人才积累; 2、公司员工对公司制度认同程度较高,研发团队稳定且积极性高; 3、公司长期坚持守信重义原则,与员工、客户及合作伙伴建立了良好的信任关系,信

	任成本较低。谢谢!		
	二十二、请问您认为现在公司所处行业的政策风险在哪些		
	面?		
	副总经理、董事会秘书 张娜: 您好,公司所处行业目前受		
	产业政策和税收优惠政策的支持力度较大,面临的政策风险		
	较小。谢谢!		
	二十三、公司未来在销售渠道上会有哪些规划?		
	董事兼总经理 徐德勇: 您好! 公司持续加强销售渠道精细		
	化管理,不断拓展一些有资源的代理商和经销商,谢谢!		
	业绩说明会过程中,公司接待人员严格按照有关制度规定,		
	没有出现未公开重大信息泄露等情况。		
附件清单(如有)			
日期	2021年4月29日		